

2024 年 5 月 15 日

会 員 各 位

一般社団法人日本食品包装協会  
理事長 石谷 孝佑

[第 7 回 Next Package 2024“人と技術の交流が未来を包む”]への  
出展ご参加のお願い

拝啓

平素より、当協会の事業運営につきましては、格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

昨年は【第 6 回 Next Package 2023】を皆様のご協力により開催できましたこと、心より感謝申し上げます。お陰様で、展示会には 337 名の皆様にご参加いただきました。

今年も展示会『第 7 回 Next Package 2024“人と技術の交流が未来を包む”』を開催いたします。ここに、出展企業様へのご参加募集のご案内を申し上げます。

自社製品の紹介(会社紹介、ご提案等)、包装材料に関する情報収集を希望される企業様を一堂に会した展示会を開催することと致しました。

昨年の盛況を受け、今年会場を拡大してより多くの皆様と交流できる体制を整えました。食品企業様はじめ多数の来場者にご参加いただけると共に、パリでのオリンピック・パラリンピックの熱を受けて昨年にも増した包装材料に関する熱い情報交換や提案が期待されますので、是非ともご出展ご参加下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 主 催 : 一般社団法人 日本食品包装協会
2. 参加方法: ポスター・商品展示による展示会出展(秋葉原 UDX ギャラリーNEXT-1 および 2)
3. 開催日 : 2024 年 11 月 28 日(木)10:00~17:00
4. 申込期限: 2024 年 10 月 4 日(金)  
※出展数には限りがあります。ご承知おきください。
5. 申込方法: 添付の「出展申込書」に、必要事項明記の上、事務局に送付をお願いします。
6. 出展費用: 55,000円(税込)/企業

ご不明な点やご質問等がありましたら、なんなりとお問い合わせください。

事務局:(一社)日本食品包装協会 石井事務局長  
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-5-1  
TEL: 03-3669-0526 FAX: 03-3669-1244  
E-MAIL: [shokuhou@j-fpa.com](mailto:shokuhou@j-fpa.com)